- (19) JP
- (11) Patent Publication No. 56-31196B2 (24)(44) JULY 20, 1981
- (54) ELECTRODE MATERIAL
- (21) Appl. No. 49-7718 (22) JANUARY 16, 1974
- (43) PUBLICATION 50-10245A AUGUST 13, 1975
- (51) Int. Cl.3: B 23K 11/30 C22C 9/00
- (72) INVENTORS: ISAMU SUZUKI, ET AL
- (71) NIHONGAKKI SEIZO KABUSHIKI KAISHA

An electrode material for welding composed of a Cr-Cu alloy containing boron in an amount of 0.01 to 0.2 wt.%. Adding boron at 0.01 to 0.2 wt.% to the Cr-Cu alloy refines the crystal grains of the alloy and improves heat resistance and high-temperature hardness without causing a substantial reduction in electric conductivity, and extends its service life.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

### 特 許 **報** (B2) 公

昭56—31196

(Int.Cl.3) B 23 K 11/30 C 22 C 9/00 識別記号

庁内整理番号 6570-4E 6411-4K

❷❸公告 昭和56年(1981) 7月20日

発明の数 1

(全4頁)

## **国電極材料**

②特 願 昭49-7718

包出 願 昭49(1974)1月16日

尒 開 昭50-102545

❸昭50(1975)8月13日

砂発 明 者 鈴木勇

浜松市上石田町 578番地

⑫発 明 者 浜野高臣

袋井市高尾 844番地の 3

⑫発 明 髙村昌幸

浜松市中沢町7番2号

**砂出** 願 人 日本楽器製造株式会社

浜松市中沢町10番1号

砂代 理 人 弁理士 猪股清

外2名15

### 匈特許請求の範囲

ホウ素を 0.0 I ~ 0.2 重量%を含有するCr-Cu 合金より成ることを特徴とする電極材料。 発明の詳細な説明

本発明は合金、特に高特性電極材料に関するも のである。

スポツト溶渉用電極材料としてCrーCu 合金 ないしCrーZrーCu合金等が知られており、と れらの合金は特に自動車工業において、軟鋼板の 25 Cr を 0.6~1 重量%含有し、他に鉄 Fe が0.03 スポツト溶接用電極として用いられている。

かかる溶接用電極は高電流、高電圧で連続的に 使用され、更に高温となるので、磨耗が激しい。 しかしながら、通常密接用電極材料として用いら れる合金はCrーCu 合金であるが、この合金は30 二元台金であり、かつ髙温(約1000℃)で熱 処理して電極を製造するため、合金中の結晶粒が 粗大化し(0.05~0.15 mmにもなる)、耐摩耗 性ないし耐熱性が低くなるという欠点がある。と の為、この $C_r-C_u$  合金に他の元素を添加して 35 性が低下して溶接用電極材料として好ましくなく 耐熱性(高温硬度)を改良する試みがなされてい る。しかしながら、CrーCu 合金は一般に他の

元素を添加すると、合金の導電率が著しく低下す るという性質を有しており、例えば、Cr--Cu合 金にNi を 0.1 %添加すれば、導電率は 8 0 %が 70%に低下する。したがつて、溶接用電極材料 5 として導電性の良好で、かつ耐熱性の優れた新規 な材料が望まれている。

2

本発明はこのような要請を満足させることを目 的とするものであり、導電率が著しく低下せず、 かつ耐熱性の優れた、したがつて摩耗の少ない容 10 接用電極材料を提供することを目的とするもので

したがつて本発明の電極材料は、ホウ素を0.01 ~ 0.2 重量%含有する Cr - Cu 合金より成る C とを特徴とするものである。

本発明の溶接用電極材料によれば、良好な導電 率を維持し(導電率の低下が著しく小さい)、か つ高温硬度の改良された、摩耗の少ない溶接用電 極を製造することができる。したがつて、本発明 の材料によつて製造された溶接用電極は寿命特性 20 が向上する。

本発明の溶接用電極を更に詳しく述べる。

まず、本発明に用いられるCr-Cu合金は従来 の溶接用電極材料として用いられるものであれば いかなるものでもよい。通常、この合金はクロム 重量%程度含有することのある銅基合金である。

かかるCr-Cu の合金に添加されるホウ素B は 0.0 1 ~ 0.2 重量%である。 Cr - Cu 合金に ホウ素を添加するのは合金の結晶粒を微細にして 耐熱性、高温硬度の向上を図るためである。しか しながら、その添加量が 0.01重量%以下である と、結晶粒が充分に微細化せず、粒界強化の効化 がない。したがつて、耐熱性、ないし高温硬度が 向上しない、また0.2 重量%以上であれば、導電 なる。

任意にジルコニウムZr、ベリリウムBe、チタン

て 0.01~0.2重量%、二ツケルNi,0.01~0.05 重量%、鉄Fe を 0.0 1 ~ 0.1 重量%含んでもよ い。これらの金属元素は強度および耐熱性を向上 させるために添加されるものである。

本発明の溶接電極材料を更に理解しやすくする ため、以下実施例を説明する。かかる実施例は本 発明の一態様をなすものであり、本発明の範囲内 で任意に変更可能である。

下記の配合に従つて、本発明の密接用電極材料 とCr~Cu 合金より成る電極材料を製造した。

	a*(%)	в(%)	Cu
1%Cr-Cu合金	1.0		残
1%Cr-0.05%B-Cu合金	1.0	0.05	残
1%Cr-0.15%B-Cu合金	1.0	0.15	残

%はいずれも重量%である。

Ti、ニオブNb、および銀Ag 等を単独又は組合せ ☆ 上記の配合に基づいて、合計1000kgをとり、 ルツポに入れた。このとき、クロムCrは10%Cr - Cu 合金として、ホウ素Bは1.8%B-Cu 合 金として添加された。ルツボ上方よりアルゴンガ 5 スを吹き込み、炉内を不活性雰囲気として誘導加 熱溶解した。溶け落ちた後、炉の上部に備えられ たプラズマトーチよりアルゴンプラズマジェツト 200ℓ/minで急速に昇温精錬した。このとき 誘導攪拌を100V、500~2000Aで行な 10 い、連続鋳造によりインゴツトを作成した。

> 製造されたインゴツトは熱間で押出成形(800℃) し、1000℃で2時間溶体化処理を行つた。そ の後、冷間引抜きを行い、470℃で5時間、時 効硬化処理を行つて試料を製造した。

*15* それぞれの試料は前記の配合に従つて上記の工 程ないし条件で製造されたものである。

これらの試料は蔵面率が約34%、直径が16<sup>©</sup> の丸棒である。

それぞれの試材の化学成分、及び常温特性は下 ☆20 記の第1表に示す通りである。

試材	<del></del>	化	学 成 分 %		弓張強さ kg/mi	硬 さ HV	導電率 1.ACS%
	123	Cr	В	Cu	Ky/ mm	п٧	IACS 70
A1 %Cr - Cu		0.96		残	5 1.4	1 5 8	8 3, 1
B1 %Cr - 0.0	5 % B — C u	0.98	0.0 4 2	残	5 2.0	158	8 2.0
C1 %Cr - 0.1	5 % B — C u	1.03	0.1 3	残	5 2.9	165	: 8 0.3

例1と同様な方法で製造した試材(蔵面率3430 %、直径16<sup>Φ</sup>)のホウ素Bの添加による試材の 導電率の変化について調べた。

結果は第1a図に示す通りである。比較として、 例1と同様に製造されたニンケルあるいは鉄を含 有するCr-Cu 合金より製造された試材のニツ 35 ケルあるいは鉄の含有量に対する導電率の変化を 調べた。結果は第1b図に示す通りである。

第1a図、第1b図より明かなように、ホウ素 Bを含有するCr-Cu 合金から成る試料はホウ 素Bの含量が 0.0 1 ~ 0.2 重量%において導電率 40 の著しい低下がないのに較べて、ニツケルNiあ るいは鉄Fe を含有するCrーCu 合金より成る 試料はニツケルNi あるいは鉄Fe を含有するこ とにより導電率は著しく低下した。

例1と同様な方法で製造された本発明の試材と、 従来の試材について高温硬度の測定をなした。と れらの試材は被面率約34%、直径16年の丸棒 である。

それぞれの試材の成分は下記の通りである。

	クロム(%)*·	ホウ素(%)
試材A	0.96	1
" B	0.98	0.042
" C	1.03	0.13

\* %はいずれも重量%

これらの試材の残部はいすれも銅である。

高温硬度の測定は常温から800℃まで100℃ の間隔で行つた。一定温度には10分間それぞれ 保持した。

測定は高温微小硬度計HT-5型(日本光学製) を用いて行なわれた。

結果は第2図に示す通りである。

第2図において縦軸はピツカース硬度(HV) を示し、横軸は温度を示す。また • - · • は試材 A、5 ○ 一 ○は試材B、×ー×は試材Cの温度による硬 度変化を示している。

第2図より明かなように、本発明の溶接用電極 材料(試料B,C)は試料Aに比して高温におい て良好な硬度を示した。

### 例 4

例1と同様な方法で製造された例3における試 材A,B,Cを用いて磨き鋼板(SPC-1)に対す る溶接点数と電極チップの長さの消耗量を調べた。 溶接機の定格容量は 2 5 KV Aであり、最大溶接 15 図面の簡単な説明 電流は12500Aである。

榕接条件は下記に示す通りである。

### 容接条件

溶接電流	1 2 5 0 0	A
初期加圧時間	2 1	サイクル* 20
溶接時間	1 9	サイクル
保持時間	1 6	サイクル
開放時間	2 2	サイクル
加圧力	4 3 0	kg

ここでサイクルとは 1/6 0 秒のパルスを言え 25 縦軸は硬度(ビツカース硬度)、横軸は温度(で)を 用いられた被密接材料はみがき鋼板(厚さ2㎞) を3枚重ねで密接した。

電極チツプ形状は第3図に示す通りである。 電極チップは上下同一形状であった。

上記の溶接条件で1~50点、51~100点、30 101~300点、301~500点、501~

1000点まで連続スポツト溶接を実施した。あ らかじめ、上下の電極チップの長さを測定してお き一定の点数に違したとき、上下電極チツブの長 さを測定し、その差を長さの消耗量(ໝ)とした。 消耗量測定後、電極チツプをヤスリで修正した。 結果は第4図に示す通りである。

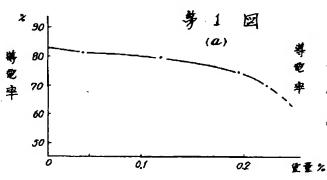
第4図において、縦軸は電極チップの長さの消 費量(෩)、横軸は溶接点数を示す。

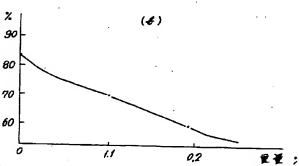
また、● - ●は試料A、 o - oは試料B、×-10 ×は試料Cの溶接点板にえる電極チップの消耗量 ( mm)を示す。

第4図より明かなように、本発明の電極チップ は従来の電極チップに比べて消耗量が著しく少な かつた。

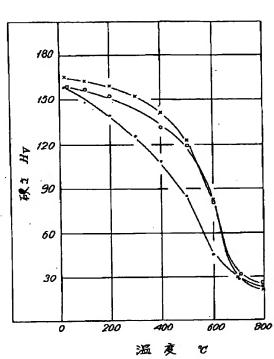
第1a図は本発明のホウ素Bを含有する1%Cr ーCu 合金より成る試材のホウ素含量に対する導 電率を示すグラフである。グラフにおいて縦軸は 導電率(%)、横軸はホウ素含量(重量%)を示 2. す。第1b図はニツケルNiを含有する1%Cr - C u 合金より成る試材の導電率を示すグラフで ある。グラフにおいては縦軸は導電率(%)、横軸は Niの重量名を示す。第2図は試材A,B,Cに 対する温度による硬度変化を示すグラフである。 示す。第3図は電極チップ形状の側面図を示す。 第4図は溶接点数と電極チップの消耗量を示すグ ラフであり、縦軸は電極チツプの長さの消耗量 (mm)、横軸は密接点数を示す。

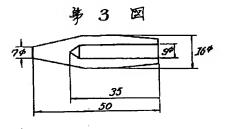
第2図および第4図において ●-●は試材A、 ○一○は試材B、×一×は試材Cを示す。











# 第 4 図

